

**2025年3月期**

# **第2四半期 決算説明**

**2024年11月7日**

**芝浦メカトロニクス株式会社**

## 目次

- 1. 2025年3月期 第2四半期 連結業績**
2. 2025年3月期 連結業績予想
3. 中期経営計画の進捗

## 業績サマリー

### ■ 売上高・利益

#### ➤ 前年比 増収増益

売上高 364億円（19%増）、営業利益 57.5億円（15%増）  
半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加

### ■ 業績予想

#### ➤ 通期業績予想、年間配当予想を上方修正

売上高 751億円、営業利益 124億円、ROS 16.5%、配当 243円

### ■ 受注高

#### ➤ 半導体前・後工程とも回復 369億円、前年比 11%増加、前下期比 29%増加

半導体前工程は、顧客拡大に伴い、ロジック/ファウンドリ向け枚葉式リン酸エッチング装置が増加  
半導体後工程は、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調

### ■ 受注残高

#### ➤ 2024年9月末 603億円

## 業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	23/上	23/下	24/上 実績	対前年 増減率
売上高	305	371	364	+19%
営業利益	50.2	66.7	57.5	+15%
R O S	16.4%	18.0%	15.8%	-0.6pt
経常利益	50.3	65.8	55.5	+10%
当期純利益	38.7	49.2	41.0	+6%
受注高	333	285	369	+11%
F C F	46.3	-9.7	34.3	-12.0億円

\* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

### ■ 売上高

前年比19%増収 (305億円 ⇒ 364億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は微増、流通機器分野が改刷特需により増加。

### ■ 営業利益

前年比15%増益 (50.2億円 ⇒ 57.5億円)

- SPE分野、流通機器分野の売上増加により増益。

### ■ 受注高

前年比11%増加 (333億円 ⇒ 369億円)

- 半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、後工程の生成AI用GPU用途を含む先端パッケージ向け装置が好調に推移。  
流通機器分野が改刷特需により増加。

## セグメント別業績結果 (対前年) ①

### ■ ファインメカトロニクス部門

\* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比1%減 (236億円 ⇒ 234億円)

半導体前工程では、前年度受注減少の影響を受け減少。

FPD前工程では、低調で微増。

➤ セグメント利益 前年比26%減 (49.7億円 ⇒ 36.9億円)

半導体前工程の売上減少、販売費及び一般管理費の増加等により減益。

➤ 受注高 前年比19%増 (200億円 ⇒ 238億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が好調に推移。

FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

## セグメント別業績結果 (対前年) ②

### ■ メカトロニクスシステム部門

\*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比91%増 (47億円 ⇒ 90億円)  
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。  
FPD後工程では、低調で前年同等。  
真空応用装置では、半導体分野向けが堅調で増加。
- セグメント利益 前年比363%増 (前年3.6億円 ⇒ 16.6億円)  
半導体後工程及び真空応用装置の売上増加により大幅増益。
- 受注高 前年比9%減 (103億円 ⇒ 94億円)  
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。  
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

## 業績結果 (対前回見通し)

\*1: 2024年8月公表

(単位: 億円)

	24/上		
	前回見通し *1	実績	対前回見通し 増減率
売上高	343	364	+6%
営業利益	51.4	57.5	+12%
R O S	15.0%	15.8%	+0.8pt
経常利益	51.3	55.5	+8%
当期純利益	38.3	41.0	+7%
受注高	-	369	-

### ■ 売上高

前回見通し比6%増収 (343億円 ⇒ 364億円)

➤ SPE分野が順調に推移

### ■ 営業利益

前回見通し比12%増益 (51.4億円 ⇒ 57.5億円)

➤ 売上増加、経費減少

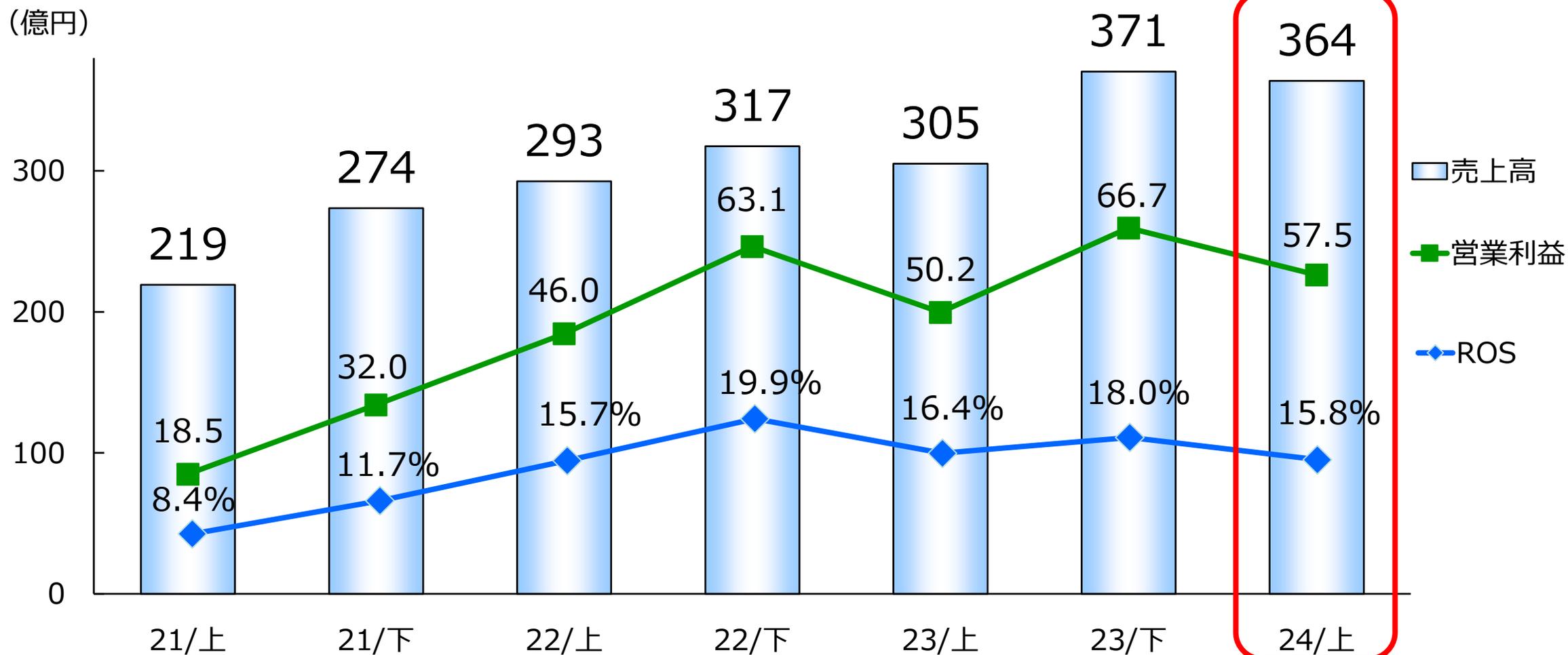
### ■ 当期純利益

前回見通し比7%増益 (38.3億円 ⇒ 41.0億円)

## 売上高・利益・ROS

ROS15.8%

(億円)

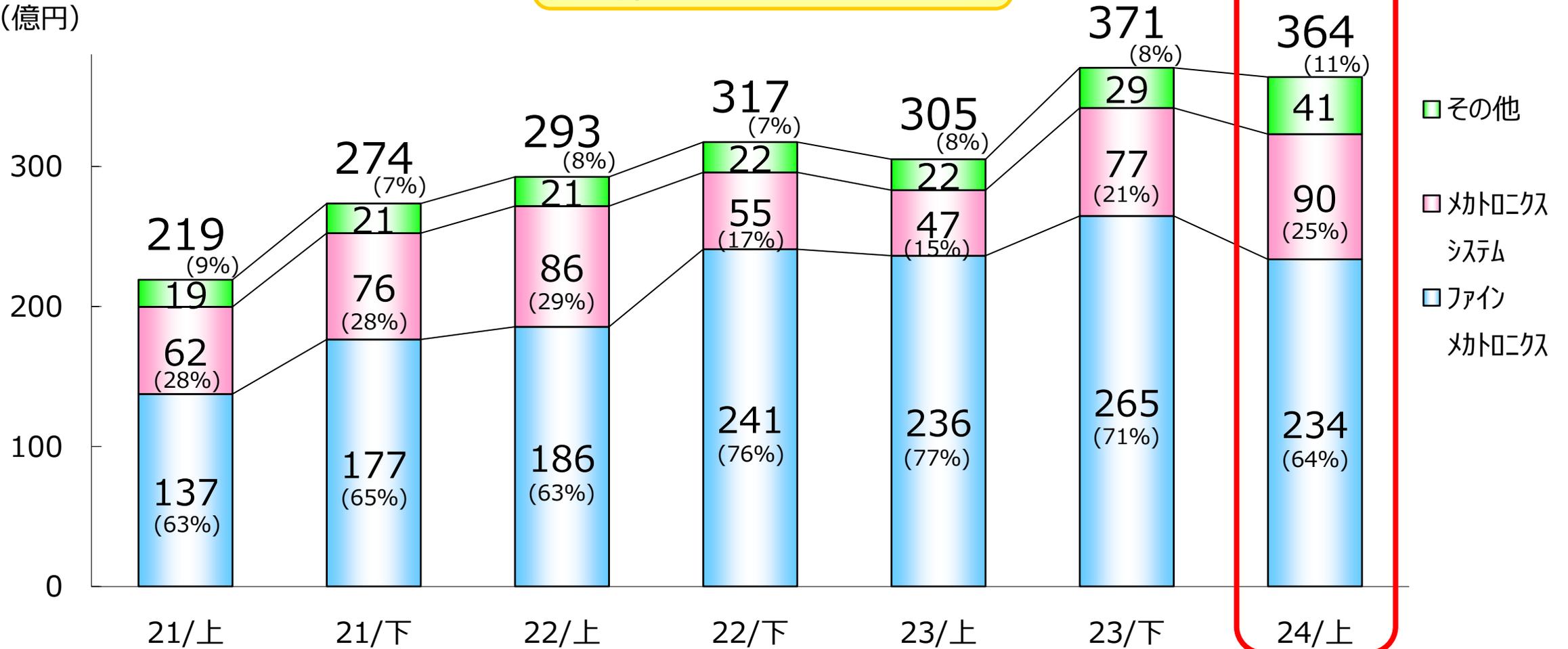


## セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 64%  
 メカトロニクスシステム 25%

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
 メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

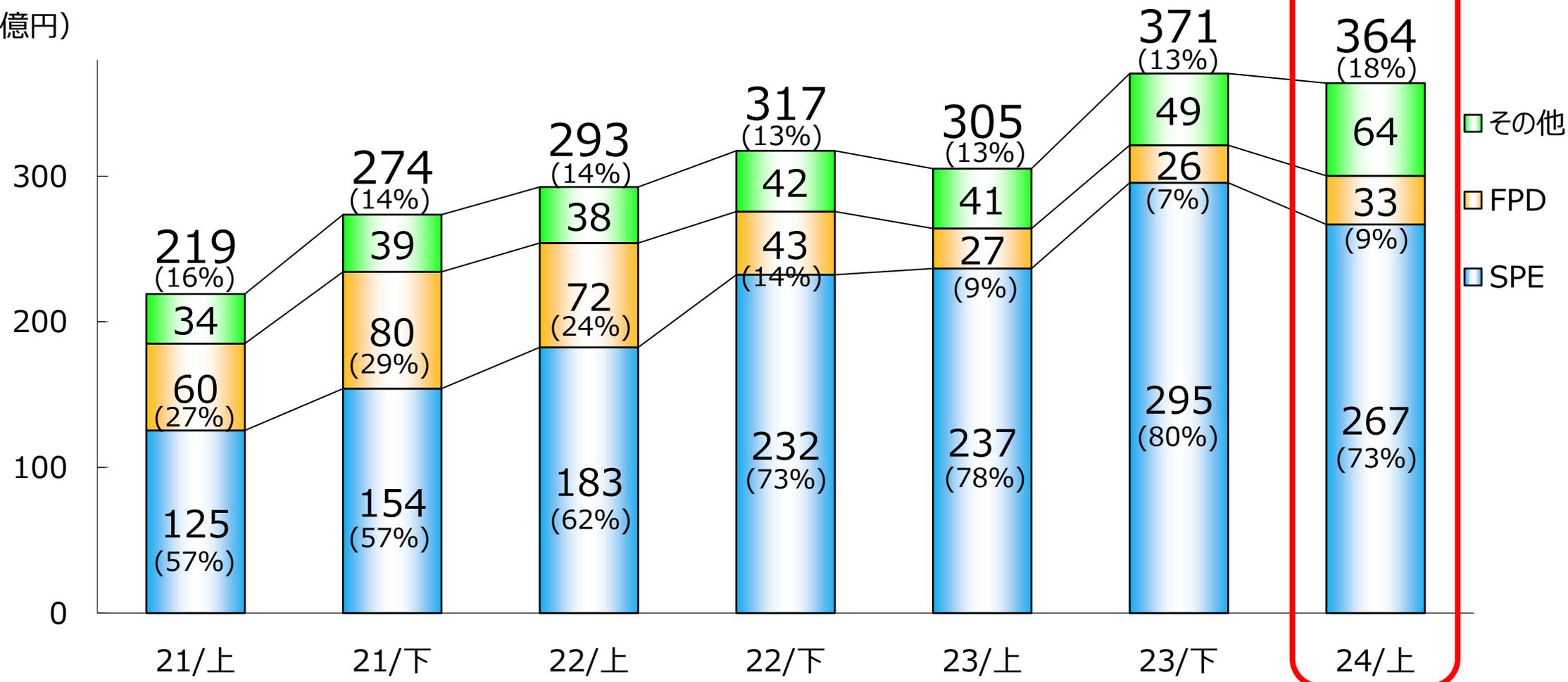


## 分野別売上高

SPE分野 73%

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

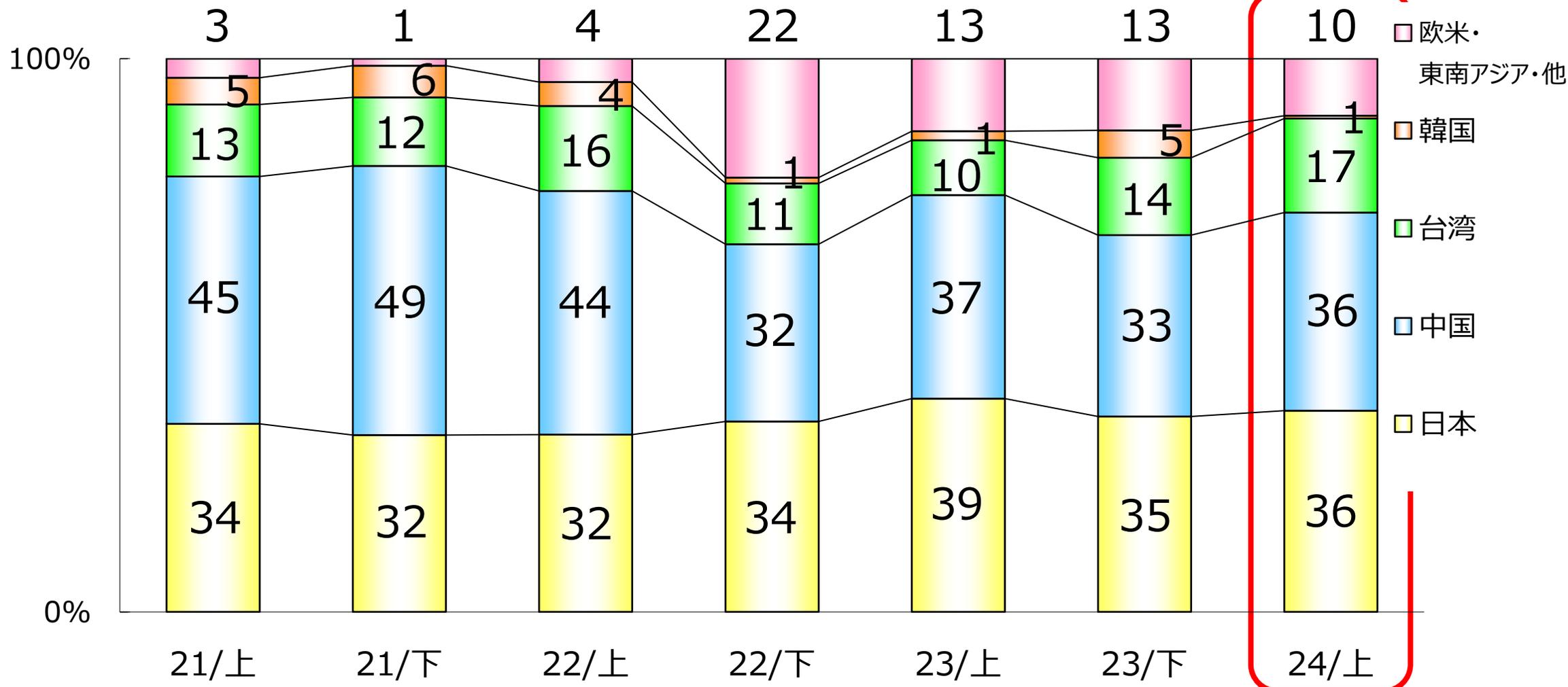
(億円)



## 地域別売上高比率

海外向け64% (中国36%)

\* 仕向地で区分

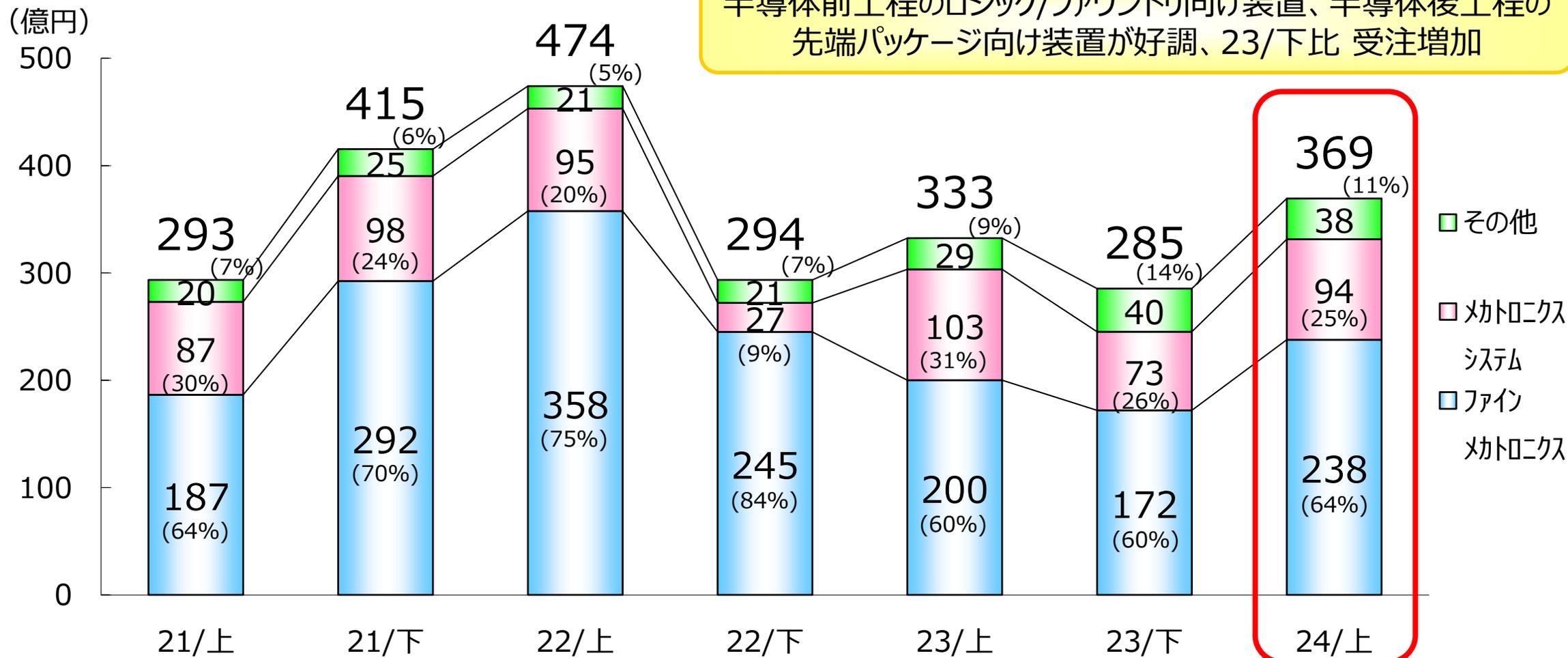


## セグメント別受注高

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

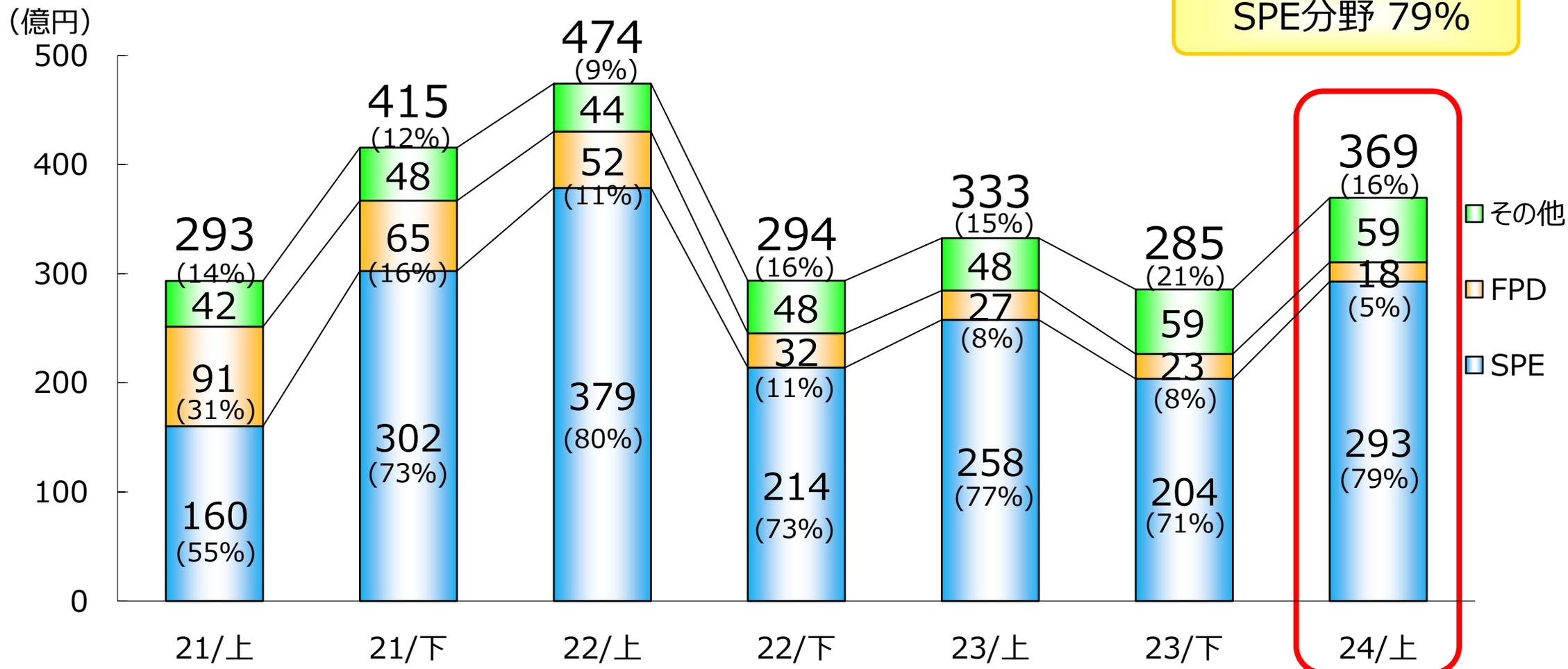
半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、半導体後工程の先端パッケージ向け装置が好調、23/下比 受注増加



## 分野別受注高

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置

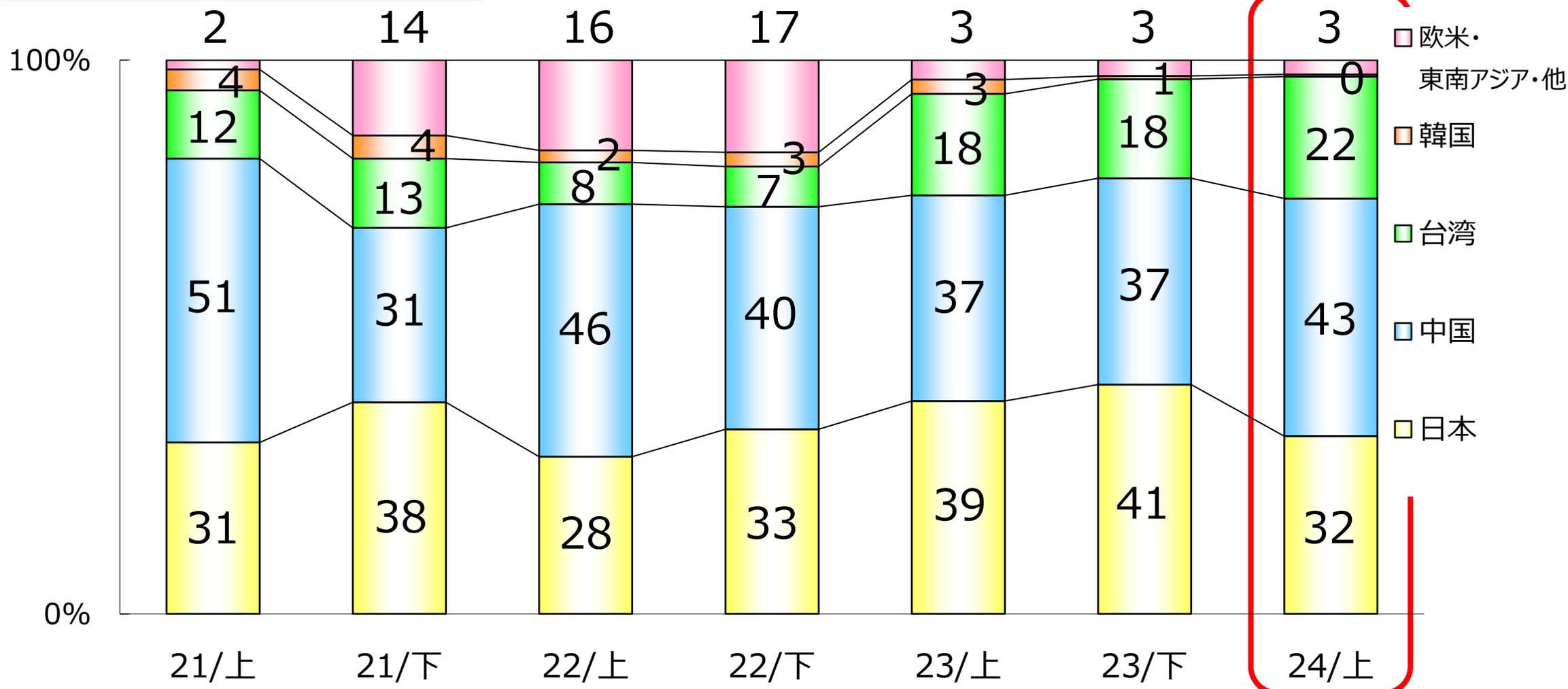
SPE分野 79%



## 地域別受注高比率

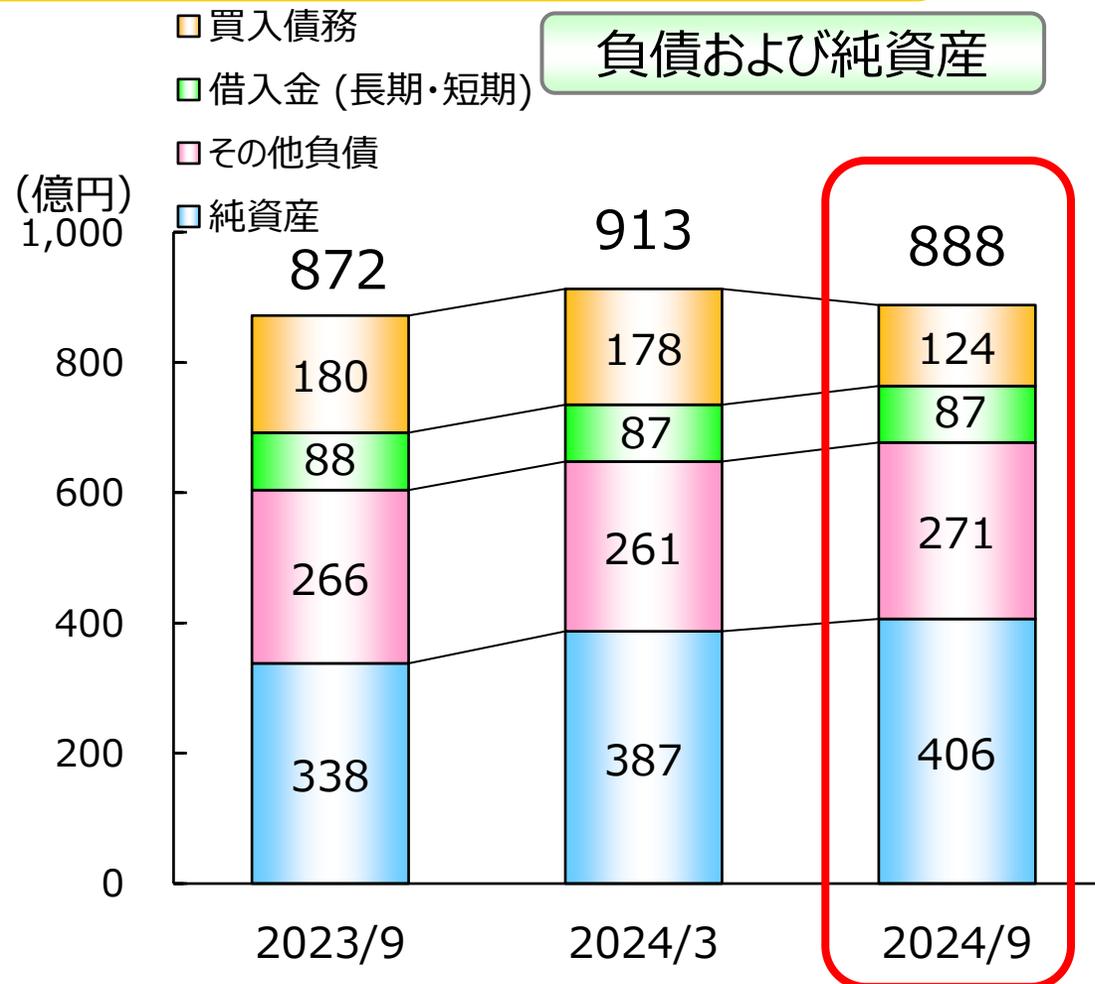
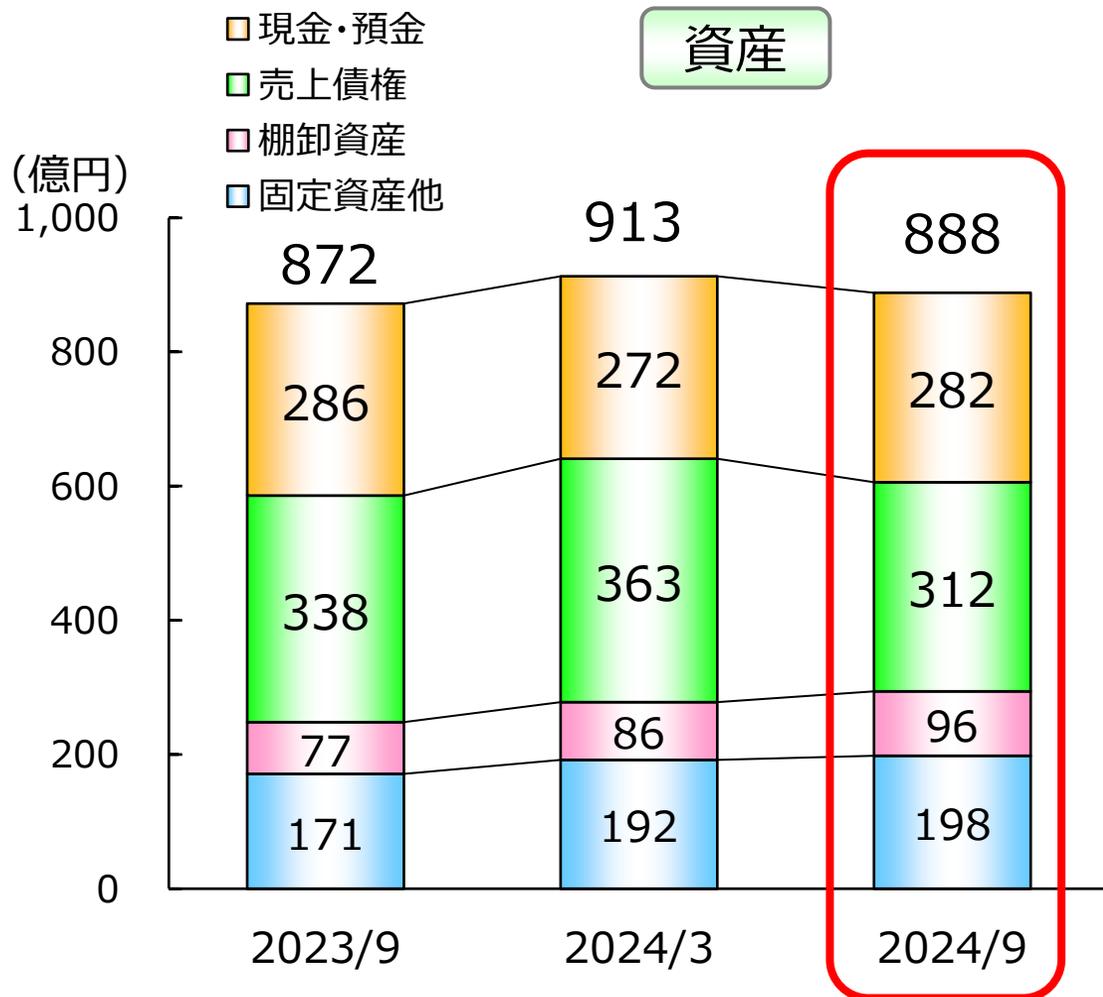
海外向け68% (中国43%)

\* 仕向地で区分



## 貸借対照表

自己資本比率 42% ('24/3) → 46% ('24/9)  
 D/Eレシオ 0.23倍 ('24/3) → 0.21倍 ('24/9)



## 目次

1. 2025年3月期 第2四半期 連結業績
- 2. 2025年3月期 連結業績予想**
3. 中期経営計画の進捗

## 業績予想サマリー

### ■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、生成AI向けの投資継続。ウェーハプロセス向け中心に中国市場での引合い継続。ロジック向けの他、後半からのメモリ向け設備投資の回復にも期待。  
FPD業界は、依然として設備投資が低水準だが、OLEDパネル向け投資に期待。
- 当社として中長期的には市場の伸長とともに成長を目指す。

### ■ 通期業績予想

- 2024年度業績は、業績進捗等を踏まえ前回8月予想から上方修正

売上高	730億円	⇒	751億円 (前回予想比+3%)
営業利益	118億円	⇒	124億円 (前回予想比+5%)
ROS	16.2%	⇒	16.5% (前回予想比+0.3pt)
配当	235円	⇒	243円 (前回予想比+8円)

# 2024年度 業績予想 (2)

## 業績予想

2024年度は前回予想から  
売上高、利益とも上回る見込み

\*1: 2024年8月公表

(単位: 億円)

	2021 年度	2022 年度	2023		2023 年度	2024		2024 年度 予想	前回予想 *1		2024 年度
			23/上	23/下		24/上 実績	24/下 見通し		24/上 見通し	24/下 見通し	
売上高	493	610	305	371	676	364	387	751	343	387	730
営業利益	50.5	109.1	50.2	66.7	116.9	57.5	66.5	124.0	51.4	66.6	118.0
R O S	10.3%	17.9%	16.4%	18.0%	17.3%	15.8%	17.2%	16.5%	15.0%	17.2%	16.2%
経常利益	48.8	105.1	50.3	65.8	116.1	55.5	65.5	121.0	51.3	65.7	117.0
当期純利益	29.8	92.0	38.7	49.2	87.9	41.0	50.0	91.0	38.3	49.7	88.0
R O E	12.8%	31.9%	-	-	24.5%	-	-	21.6%	-	-	21.0%
F C F	77.9	32.0	46.3	-9.7	36.8	34.3	-28.3	6.0	-	-	6.0

## 配当予想

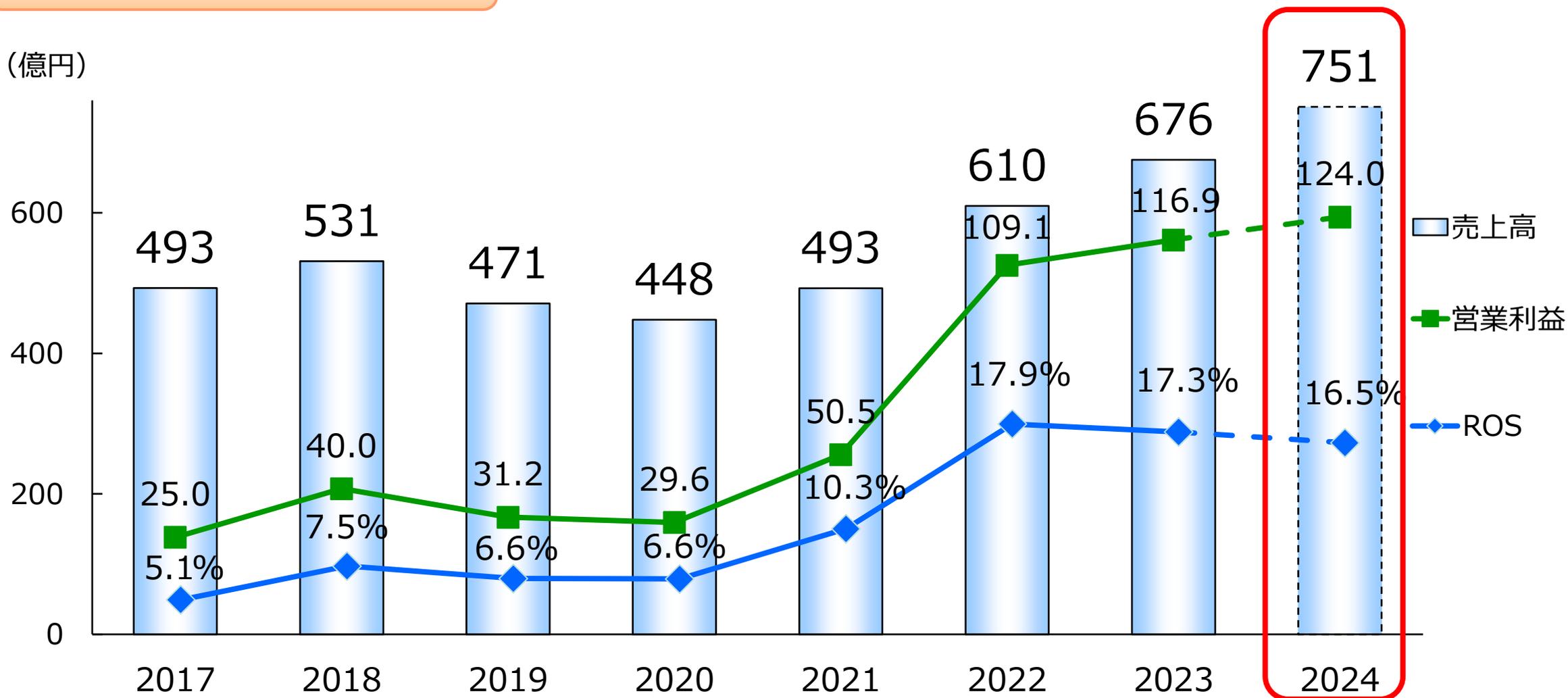
当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。  
 2024年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は前回予想から8円増配の243円（配当性向 35.0%）を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2025年3月期）	0円	243円	243円
前回予想（2025年3月期）	0円	235円	235円

（ご参考）2024年3月期 年間配当200円

## 売上高・利益・ROS

(億円)



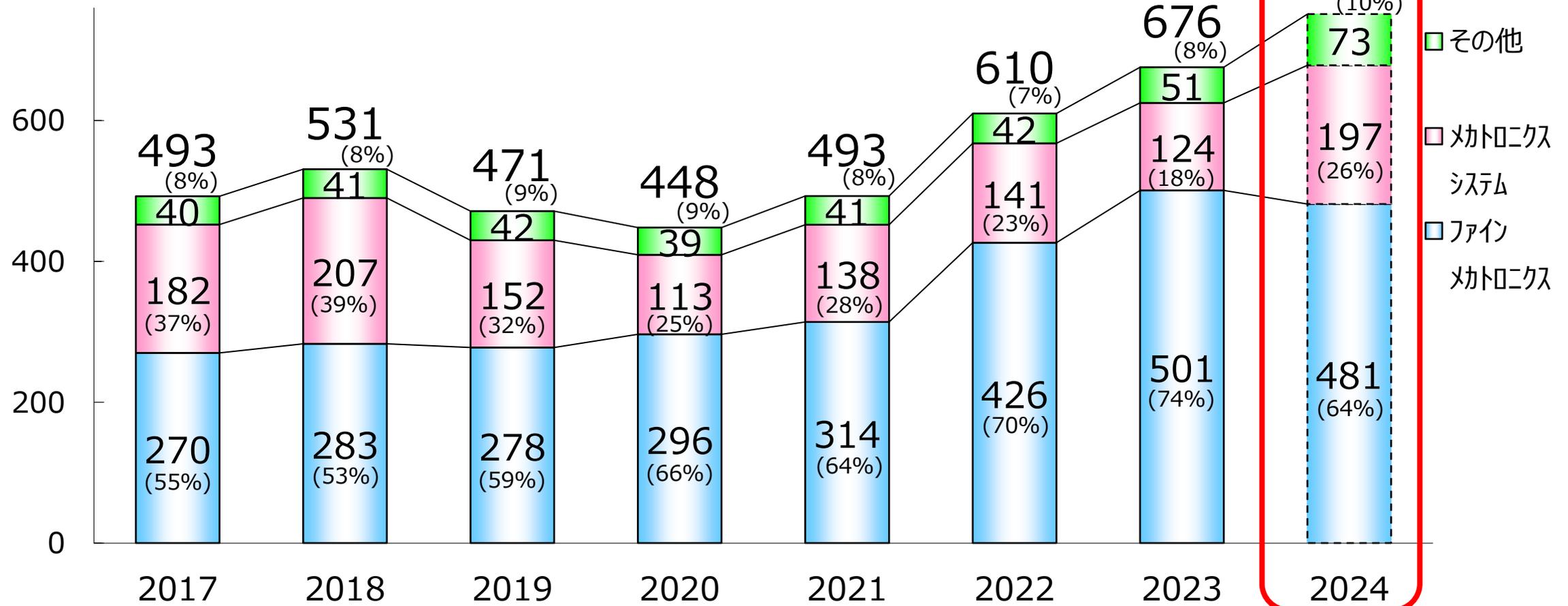
# 2024年度 業績予想 (5)

## セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 64%  
メカトロニクスシステム 26%

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)



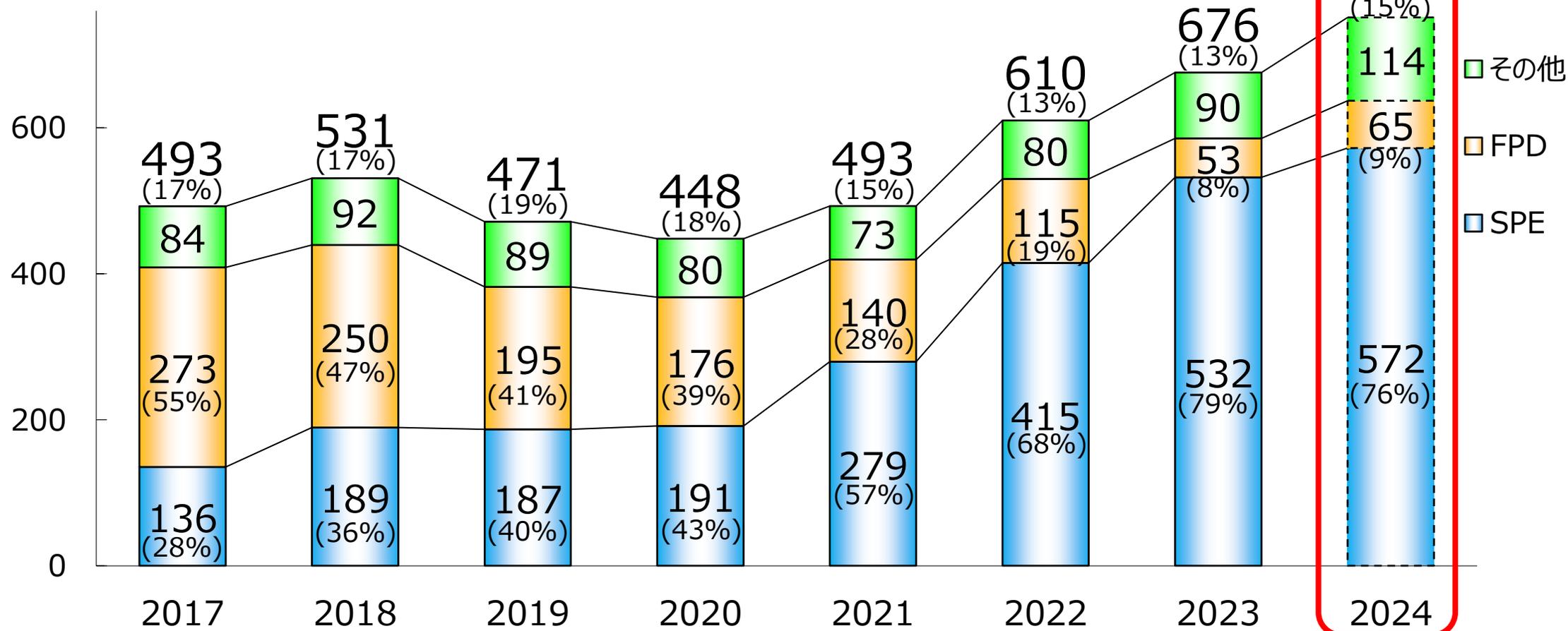
# 2024年度 業績予想 (6)

## 分野別売上高

SPE分野 76%

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

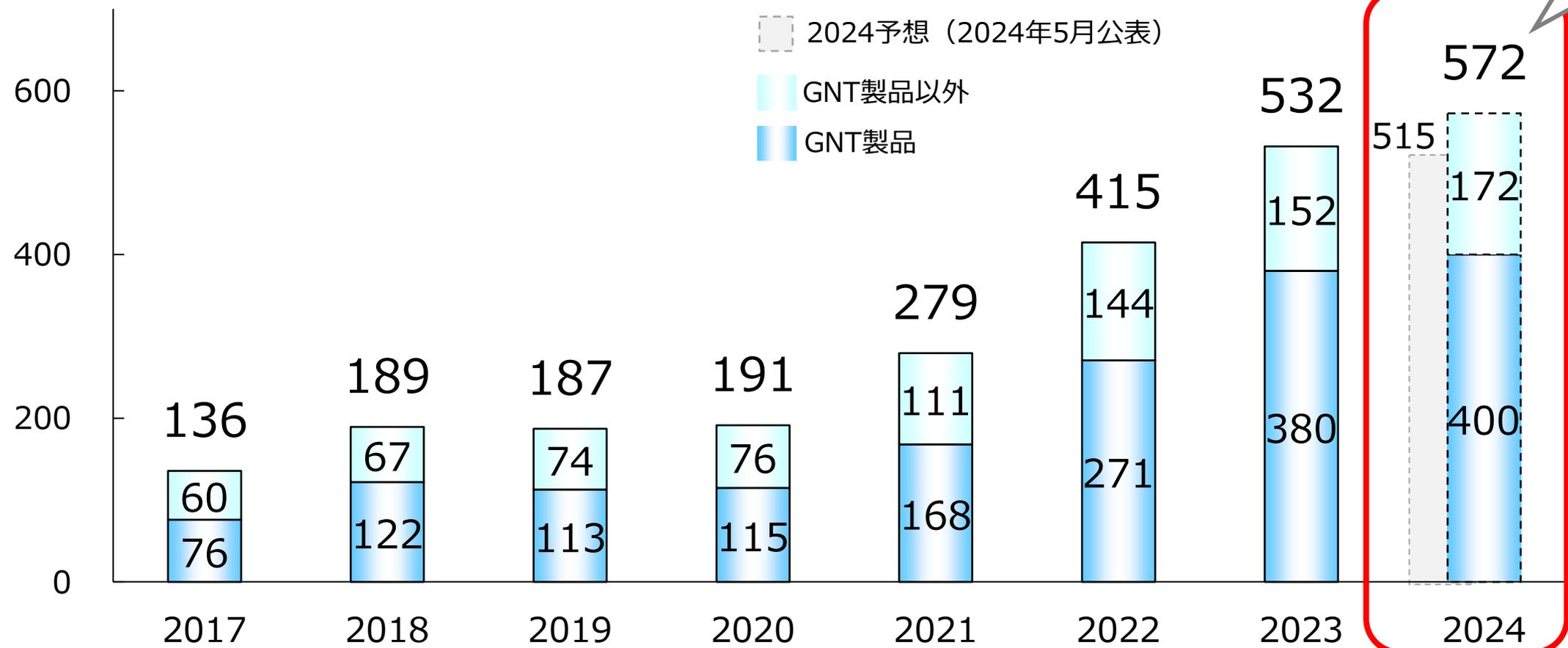
(億円)



\*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ  
対象製品群 (cf.p.30)

## SPE分野売上高

(億円)



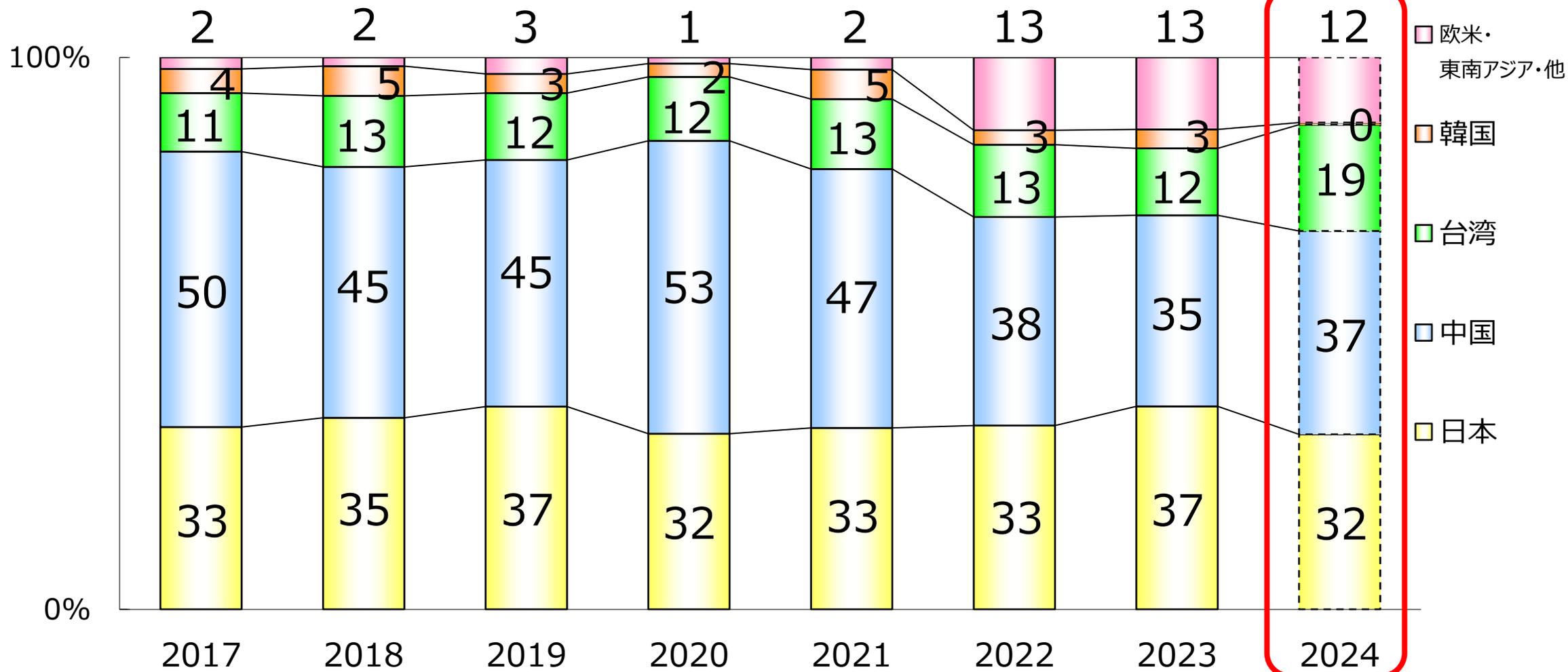
SPE全体  
売上高

# 2024年度 業績予想 (8)

## 地域別売上高比率

海外向け68% (中国37%)

\* 仕向地で区分



## 目次

1. 2025年3月期 第2四半期 連結業績
2. 2025年3月期 連結業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**

## 当社として捉える社会変化・課題

### 市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

### 技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

### 環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

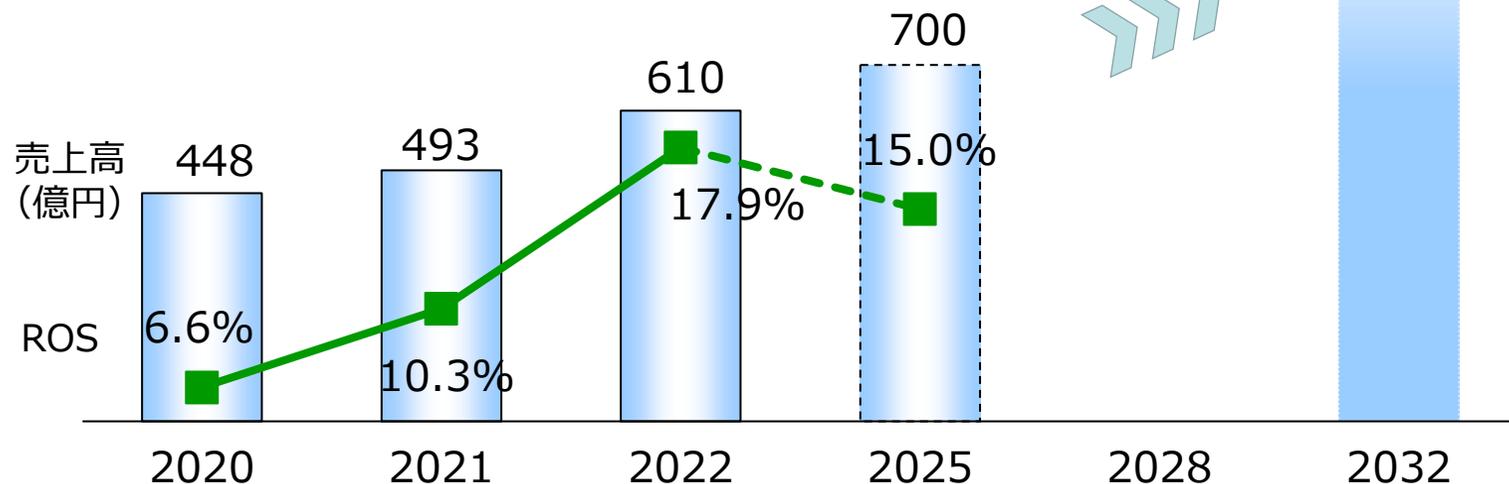
### 安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

## 10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して  
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で  
 ・売上高1,000億円以上  
 ・ROS20%以上  
 を目指す



# 中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

芝浦ビジョン2033達成

**2023-2025  
芝浦ビジョン2033  
Phase.1**

2026-2028  
芝浦ビジョン2033  
Phase.2

2029-2032  
芝浦ビジョン2033  
Phase.3

＜2025年度＞ 2023年5月公表

売上高	700億円
営業利益	105億円
R O S	15%
R O E	17%

**2024年度の達成状況と  
市場環境をもとに再設定**

「持続的成長に向けた投資」を柱として、  
次の成長に向けた土台強化を進め  
再び営業利益100億円超を目指す

4  
つ  
の  
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

# 中期経営計画進捗 (1)

## 中期経営計画の進捗

2024年度は中計公表より  
1年前倒しで達成見込み

(単位：億円)

	2023 年度実績	2024 年度予想	2023年5月 中計公表		
			2023	2024	2025
売上高	676	751	590	680	700
営業利益	116.9	124.0	73.0	95.0	105.0
R O S	17.3%	16.5%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	116.1	121.0	-	-	-
当期純利益	87.9	91.0	-	-	-
R O E	24.5%	21.6%	15.0%	17.0%	17.0%

## 分野別市況と当社の方向性

\*1 出典 : TechInsights Inc. 2024-10

\*2 出典 : Display Supply Chain Consultants, LLC 2024-9  
いずれも暦年、グラフは当社にて作成

S  
P  
E

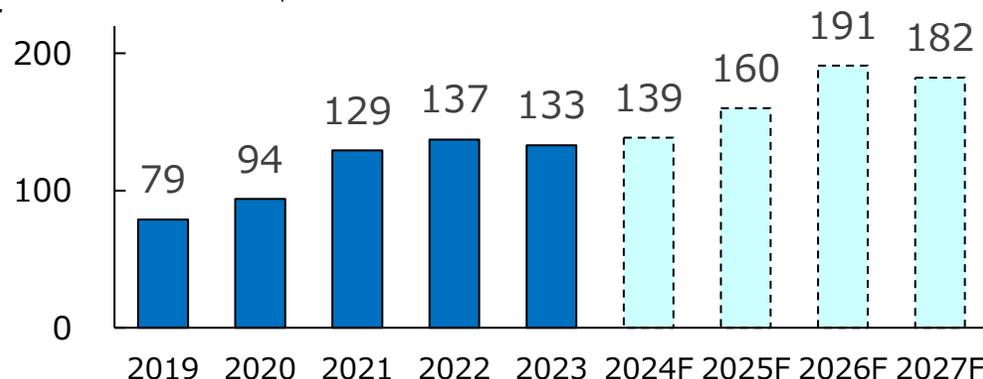
- 前工程ではウェーハプロセス向け中心に堅調な引合い継続、シリコンウェーハ向けは中国ユーザを中心に緩やかな回復を想定
- 後工程では引き続き生成AI市場向けが活況となる見込み
- 社会情勢の変化や地政学リスクになり得る事象は継続注視



今後も実績のある装置の拡販・シェア拡大と、新たなGNT製品を含む次世代・先端半導体対応装置の開発・販売に注力

■ 半導体製造装置 売上高予測 \*1

(単位 : 10億US \$)



F  
P  
D

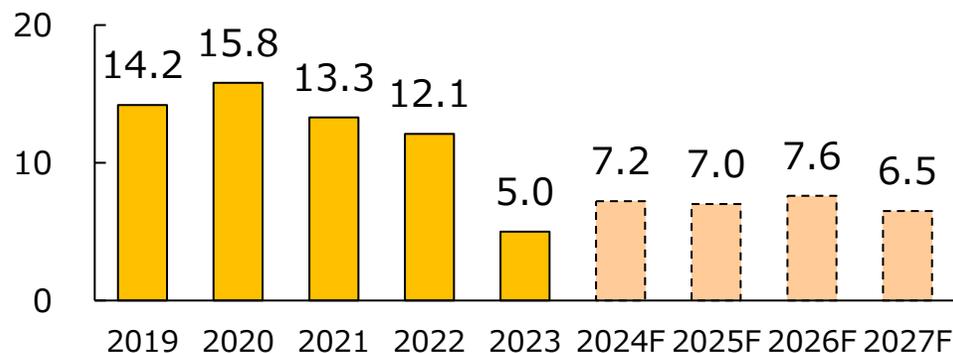
- ITパネル用大型サイズOLED投資計画の具体化に期待も、価格競争激化の様相あり
- TVパネル需要は引続き低調だが、顧客の投資に合わせ当社の実績や技術力を活かした受注活動継続



主要サプライヤとしてのポジションを堅持し、新型・次世代ディスプレイ向け製品の開発・顧客との評価・拡販に注力

■ FPD製造装置 売上高予測 \*2

(単位 : 10億US \$)



## SPE分野工程別 主要製品群

- \* いずれも環境調和型製品
- \* 当社グローバル ニッチトップ対象製品群 (GNT製品) が属す4工程 (掲載機種は一例)

### Siウェーハ製造



枚葉式Siウェーハ  
洗浄装置

### フォトマスク製造



フォトマスク  
エッチング装置



新製品

フォトマスク  
洗浄装置

### モジュールプロセス

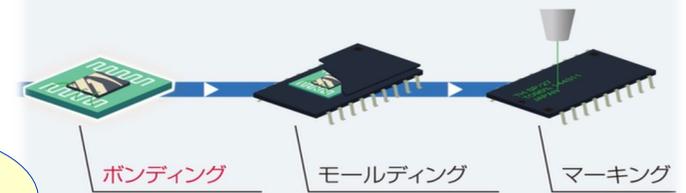
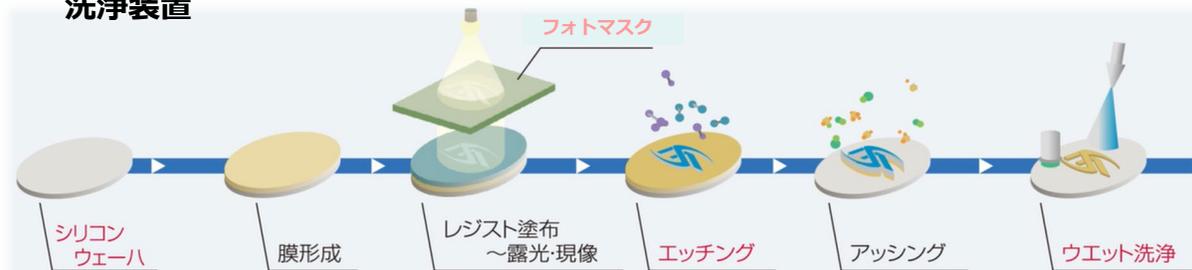


超高精度  
ハイブリッドボンダ



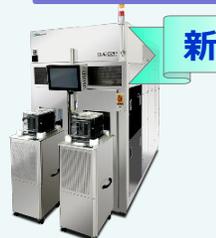
新製品

ハイエンドウェーハレベル  
パッケージボンダ



2024年  
4製品を上市

### その他の注目製品



新型ケミカルドライ  
エッチング装置



FOSB/FOUP  
洗浄装置

### ウェーハプロセス



枚葉式リン酸  
エッチング装置

- 引き続き4工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出



高精度2.5Dボンダ



高精度PLPボンダ

## 前工程トピックス

### ウェーハプロセス

ロジック/ファウンドリ  
(CPU、GPU等)  
メモリ (DRAM)

- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は先端デバイスに加えレガシー製品の受注伸長、メモリ市場への拡大に期待
- 先端デバイスに対応した優れた温度制御性の新たな加熱技術を展開、顧客とのフィールド検証に移行



### フォトマスク製造

ブランク、PSM、  
EUVマスク  
次世代EUVマスク

- ドライエッチング装置は次世代EUV対応とレガシー製品向けで継続して受注伸長
- 洗浄装置は凍結洗浄技術を搭載した新機種を24年4月上市



### Siウェーハ製造

Si、SiC、  
各材料のウェーハ

- 更なる微小パーティクル低減に向けたウェーハ凍結洗浄プロセス開発を推進、25年の上市に向けて顧客との評価を開始
- Siウェーハで培った洗浄技術をSiCウェーハ市場へ展開、26年の上市に向けてプロセス開発を加速



### その他の注目製品

パワーデバイス

- パワーデバイス向け高生産等方性エッチング装置（新型ケミカルドライエッチング装置）を上市、高温エッチング技術対応を加速



## 後工程トピックス

### モジュールプロセス



高精度2.5Dボンダ  
**TFC-6500**  
2.5D、GPU、AIチップ

- 2.5D、生成AI向けGPU市場で高評価、多くの受注を獲得中
- 接続基板（インターポーザ）の進化に伴う次期高性能ボンダ開発中

新製品



ハイエンドウェーハレベル  
パッケージボンダ  
**TFC-6600**  
FO-WLP、APEモジュール

- FO-WLP、シリコンブリッジ市場に向けた次世代ハイエンドボンダを上市
- 豊富な販売実績を誇るTFC-6100Wの後継・上位機種



超高精度ハイブリッドボンダ  
**TFC-6800**  
D2W-Hybrid、チップレット

- 従来比3倍の高い生産性を実現
- 前処理（洗浄、プラズマ）システムの研究開発進行中



高精度PLPボンダ  
**TFC-9300**  
パネルレベル、ブリッジ実装

- 大型基板へ高精度で実装、高い技術力と実績で基板実装分野へ進出
- ブリッジ実装、大きなチップの加熱実装を視野に入れた派生機種を展開

## 新製品紹介 (前工程)

当社の洗浄技術、真空技術、検査技術を結集したハイエンド仕様の洗浄装置

### ■ ニーズ

半導体製造工程の微細化に伴い、より高い清浄度と品質管理を求められている

### ■ 用途

シリコンウェーハの出荷ケースとして使用されるFOSBの洗浄やデバイス製造工程で用いられるFOUPの洗浄

### ■ 特長

- ① 独自洗浄ツールなどの優れた洗浄性能・乾燥性能  
→ 製品の歩留まり向上
- ② 品質管理のための充実したオプション検査機能  
→ 洗浄効果の見える化

- \* FOSB : Front Opening Shipping Box  
工場間のウェーハ搬送などに使用
- \* FOUP : Front Opening Unified Pod  
工場内で装置間の搬送などに使用

## FOSB / FOUP 洗浄装置 「FOC300」



[<FOSB / FOUP 洗浄装置 FOC300 series | 芝浦メカトロニクス株式会社>](#)

## 新製品紹介 (後工程)

\*UHD FO-WLP : Ultra High Density Fan Out-Wafer Level Package

アプリケーションプロセッサをはじめ高密度FO-WLP市場で豊富な実績があるTFC-6100Wの後継・上位機種

### ■ ニーズ

配線ピッチの高密度化が進むアプリケーションプロセッサ(スマートフォンなどの処理チップ)では、高精度な実装が求められる。

また、生成AI用2.XDパッケージではブリッジ接続の登場により、高精度なFace Up実装の需要が高まっている。

### ■ 用途

アプリケーションプロセッサなどのUHD FO-WLP製品およびシリコンブリッジ実装

### ■ 特長

- ① 高精度実装の実現かつ安定性の向上
- ② 高スループット

## ハイエンドウェーハレベル パッケージボンダ 「TFC-6600」



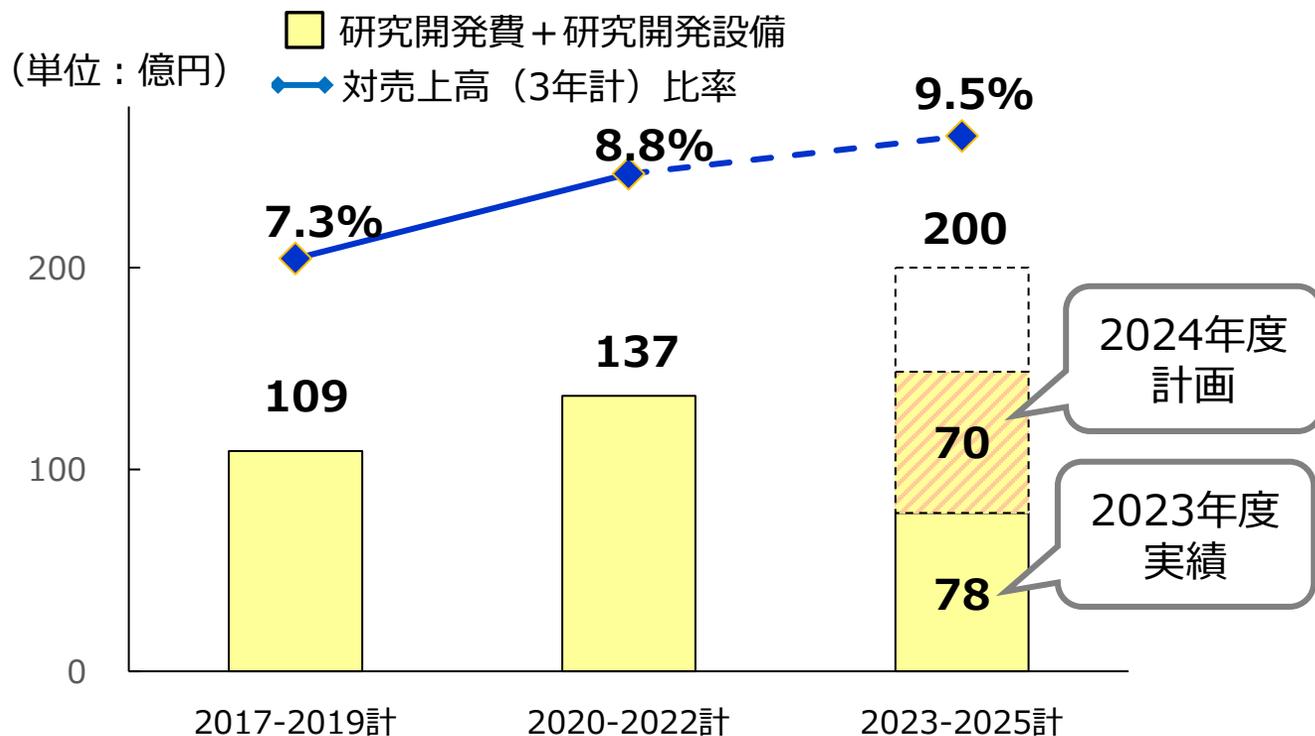
[<ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ TFC-6600 | 芝浦メカトロニクス株式会社>](#)

## 持続的成長に向けた投資

### ■ 研究開発費・研究開発設備

➤ 中計計画に沿いSPE分野中心に実行中

### ■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移 (中計期間別)



## サステナビリティ経営関連トピックス

### ■ あるべき姿達成に向けた取組みを継続

➤ 事業を通じて展開するマテリアリティより (抜粋)

環境調和型  
製品の開  
発・提供で  
グリーン社  
会に貢献

環境調和型製品売上高比率  
目標85%以上

\* 2023年度は対売上高97.6%

関連する  
SDGs目標



継続  
取組み例

- ・環境調和型製品新規創出
- ・水や薬液使用量の削減
- ・環境調和型製品に寄与する技術検討

➤ 9月に統合報告書発行

➤ コーポレートサイトのリニューアルとともに、サステナビリティコンテンツを拡充

🏠 <サステナビリティ | 芝浦メトロニクス株式会社>

A hand is shown at the bottom of the frame, palm up, holding a glowing digital globe. The globe is composed of a grid of white dots and is overlaid with a complex network of glowing blue and white circuit lines and nodes. The background is a deep blue gradient with some light bokeh effects.

この先もずっと、  
人と技術で  
社会を支える。

*Smart Solutions & Services for Your Manufacturing*

芝浦メカトロニクスグループは、  
「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で  
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、  
豊かな社会の実現を支えてまいります。

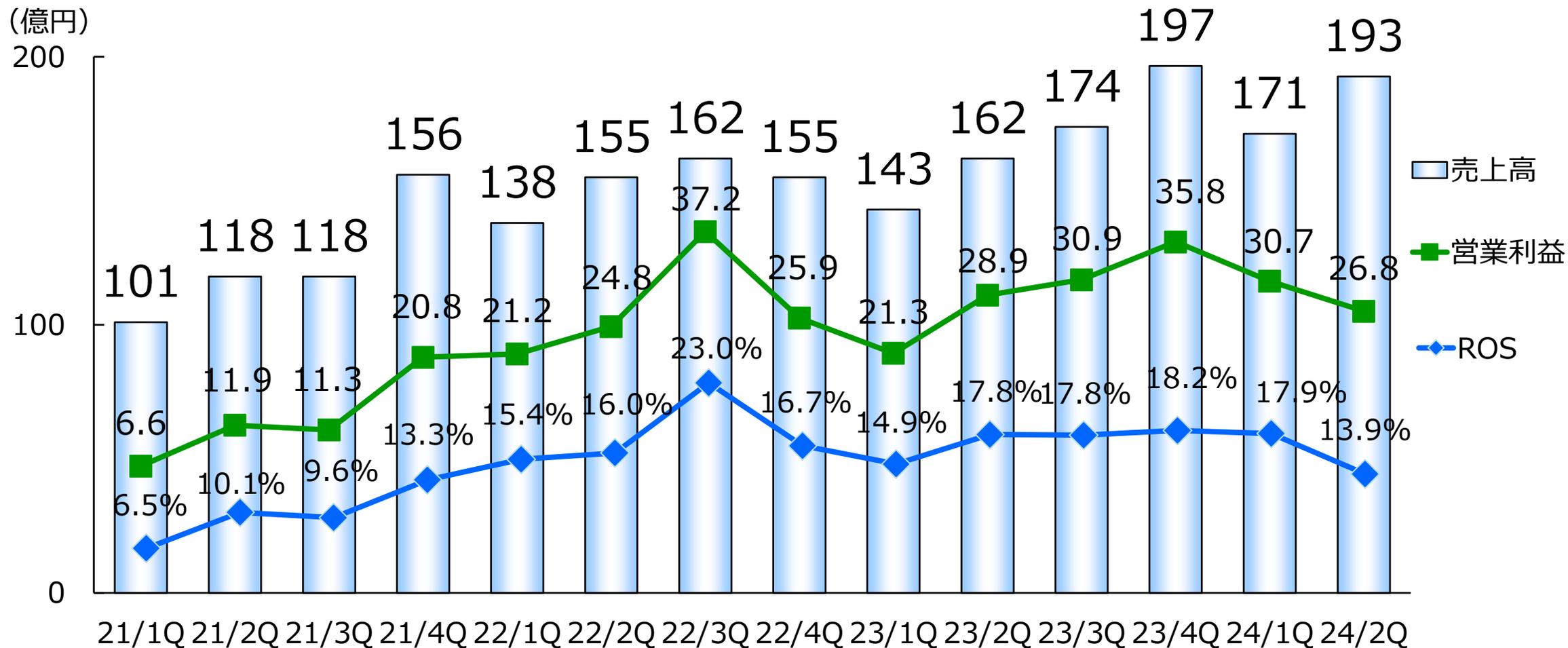
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

# Appendix

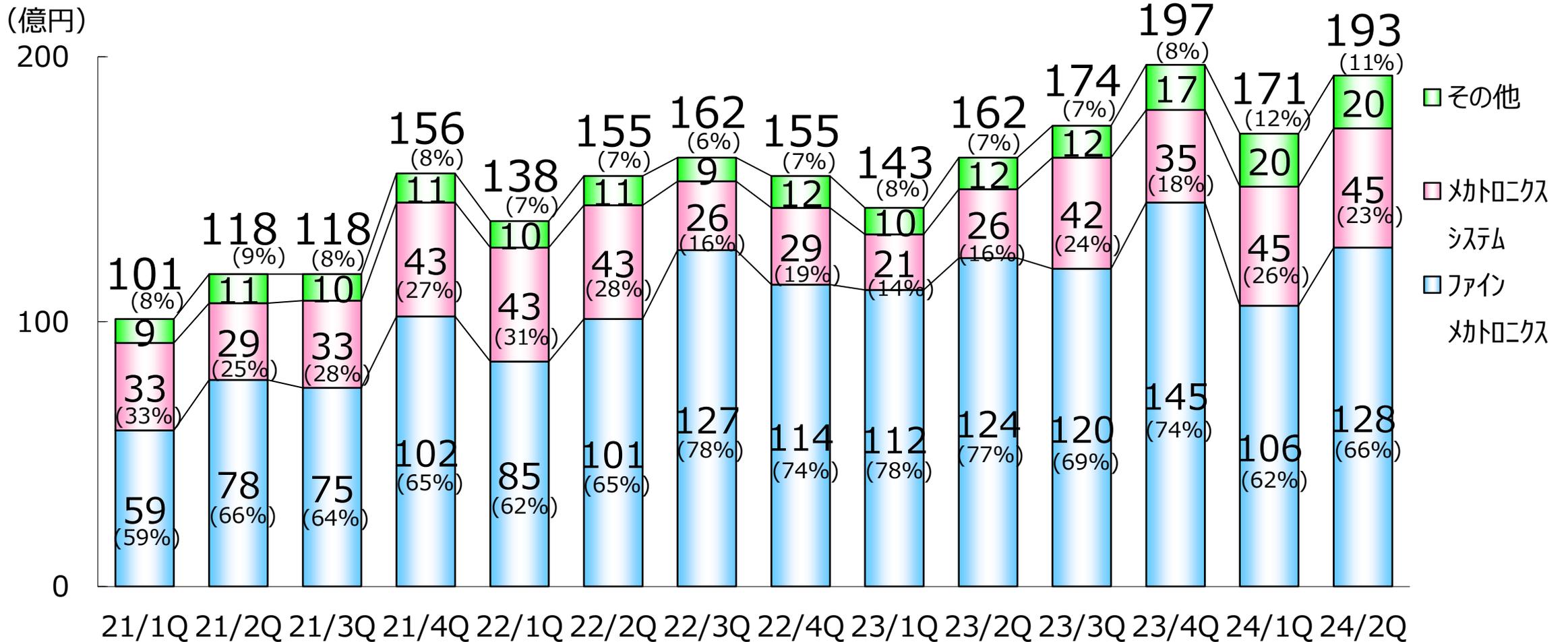
# 四半期推移 (1)

## 売上高・利益・ROS



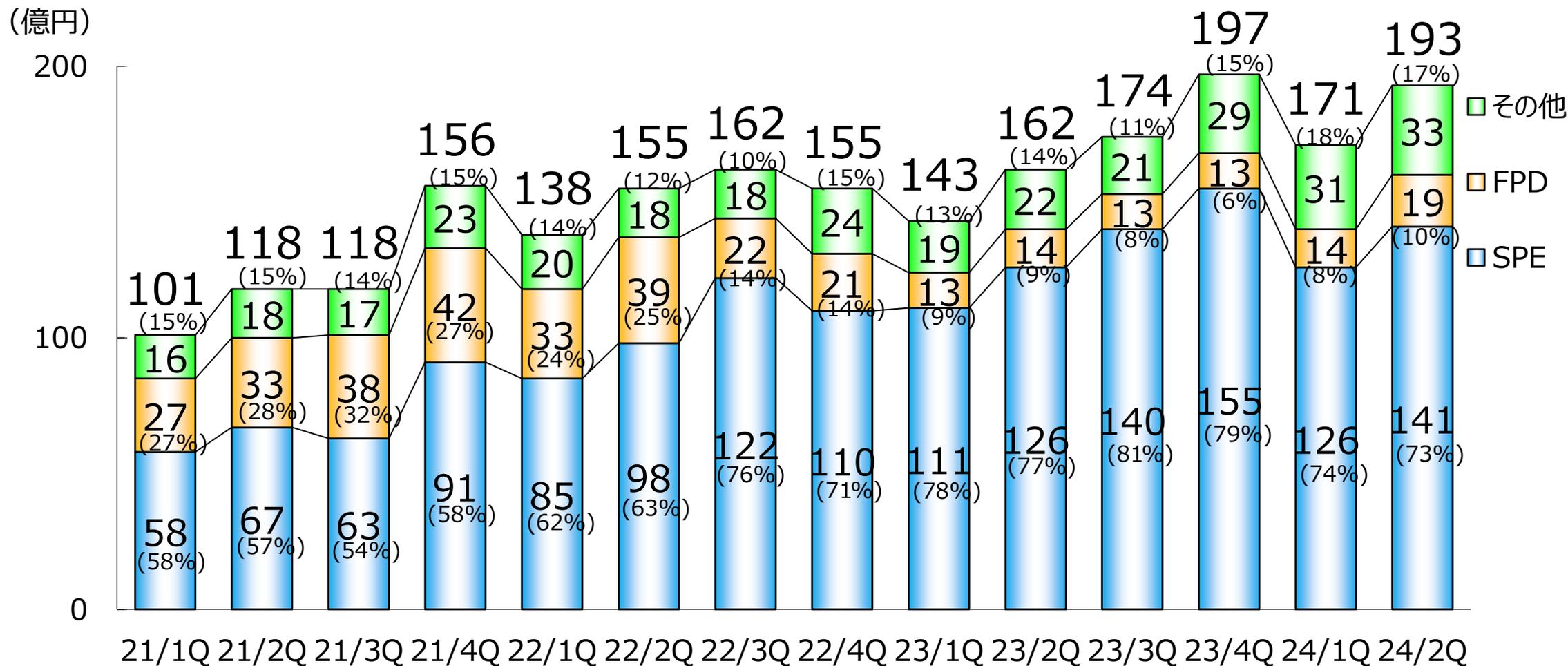
## セグメント別売上高

\* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
 エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



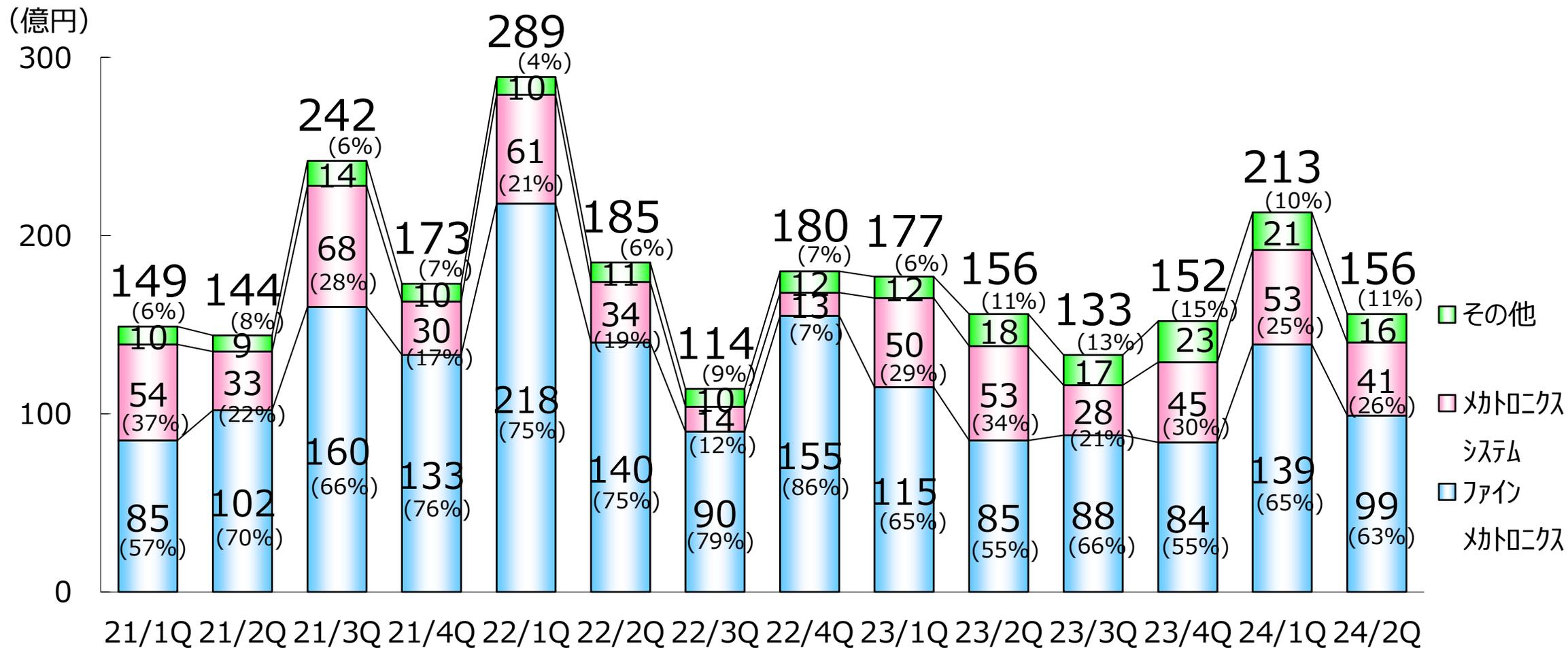
## 分野別売上高

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置



## セグメント別受注高

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



## 分野別受注高

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
 FPD : FPD前・後工程装置

